

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一九年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2019年5月9日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一九年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一九年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 2.208 億美元，同比增長 5.1%，環比減少 11.4%，主要受季節性因素、兩間工廠年度維護及市場普遍疲軟的影響。
- 毛利率 32.2%，同比上升 0.1 個百分點，環比下降 1.8 個百分點。
- 期內溢利 4,660 萬美元，同比上升 15.9%，環比下降 4.0%。
- 基本每股盈利 0.037 美元，同比下降 0.002 美元，環比下降 0.005 美元。
- 淨資產收益率（年化） 8.8%。

二零一九年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.30 億美元左右，同比持平，環比增長 4.2%。
- 我們預計毛利率約 30% 左右。

二零一八年度股利派發

董事會建議派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.31 港元。待股東於五月九日（周四）召開的股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一九年六月二十六日（周三）派付予於二零一九年五月十七日（周五）名列本公司股東名冊的股東。

總裁致辭

本公司新任總裁兼執行董事唐均君先生，對第一季度的業績評論道：

“我欣然宣佈華虹半導體二零一九年第一季度的業績表現。在半導體市場整體增速趨緩的情況下，我們又一次取得了超出預期的業績，體現出我們在差異化策略、調整有效需求戰略上的實力和品質。我們的銷售收入達 2.208 億美元，同比上升 5.1%，環比下降 11.4%，主要受季節性因素、兩間工廠年度維護及客戶需求減少的影響。毛利率保持強勁，為 32.2%，同比上升 0.1 個百分點，環比下降 1.8 個百分點，主要由於產能利用率降低。淨利潤率 21.1%，同比上升 2.0 個百分點，環比上升 1.6 個百分點。”

“儘管當前經濟環境充滿不確定性和挑戰，我們仍然保持樂觀，並堅信我們的特色工藝戰略會繼續帶領我們領跑市場。我們已經看到了一些技術平臺復蘇的跡象，尤其是 MCU 和分立器件平臺。因此，我上任後就指示團隊加速 200mm 晶圓廠產能的擴充和升級，以確保我們能在市場回暖的第一時間滿足產能需求。對這些額外的產能擴充和升級的投資是極小的，但回報將是巨大的。”唐先生說道，這代表他對 200mm 晶圓業務的未來充滿信心。

唐總裁接著提到了 300mm 晶圓項目，“該項目正處於關鍵階段，因此幾乎有一半的時間我都花在這上面。目前我對該項目的進展總體上很滿意。我們預計將在 6 月末完成廠房和潔淨室的建設，在第二季度開始搬入設備，並在第四季度開始試生產 300mm 晶圓。我們的技術研發、工程和銷售/市場團隊正在緊鑼密鼓的開發幾個新產品，為新的 300mm 晶圓生產線的初始量產做準備。”

唐先生總結道，“雖然肩負著重大責任，我非常高興和榮幸能領導這群才華橫溢、敬業奉獻的員工。十分感謝股東的支持和董事會的信任。讓我們一起將華虹半導體打造成世界上最偉大的公司！”

電話會議公告

日期： 二零一九年五月十日（星期五）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2019 年 5 月 10 日，星期五）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~1q_2019_earnings_call

電話詳細：

国际	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 1499929

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。（回放密碼：Huahong）

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（“本公司”）是全球領先的純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17.5 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	220,753	210,093	249,086	5.1 %	(11.4)%
銷售成本	(149,756)	(142,708)	(164,508)	4.9 %	(9.0)%
毛利	70,997	67,385	84,578	5.4 %	(16.1)%
毛利率	32.2 %	32.1 %	34.0 %	0.1	(1.8)
經營開支	(31,727)	(25,447)	(38,819)	24.7 %	(18.3)%
其他收入/(損失)淨額	5,457	(2,025)	11,620	(369.5)%	(53.0)%
稅前溢利	44,727	39,913	57,379	12.1 %	(22.0)%
所得稅收益/(開支)	1,914	318	(8,818)	501.9 %	(121.7)%
期內溢利	46,641	40,231	48,561	15.9 %	(4.0)%
淨利潤率	21.1 %	19.1 %	19.5 %	2.0	1.6
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	47,466	40,097	48,972	18.4 %	(3.1)%
非控股權益	(825)	134	(411)	(715.7)%	100.7 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.037	0.039	0.042	(5.1)%	(11.9)%
攤薄	0.037	0.038	0.042	(2.6)%	(11.9)%
付運晶圓(仟片)	446	454	531	(1.8)%	(16.0)%
產能利用率 ¹	87.3 %	97.3 %	96.7 %	(10.0)	(9.4)
淨資產收益率 ²	8.8 %	9.2 %	9.6 %	(0.4)	(0.8)

二零一九年第一季度

- 銷售收入 2.208 億美元，同比增長 5.1%，主要得益於平均售價提升及產品組合優化；環比減少 11.4%，主要受季節性因素，兩間工廠年度維護和需求減少的影響。
- 銷售成本 1.498 億美元，同比上升 4.9%，主要由於人員及原材料成本上升；環比下降 9.0%，主要由於上一季度計提年終獎金以及晶圓銷售量下降。
- 毛利率 32.2%，同比上升 0.1 個百分點，環比下降 1.8 個百分點，主要由於產能利用率降低。
- 經營開支 3,170 萬美元，同比上升 24.7%，主要由於人工費用和技術開發費用上升；環比下降 18.3%，主要由於在上一季度計提了設備減值準備和年終獎金。
- 其他收入淨額 550 萬美元，與上年同期其他損失淨額 200 萬美元相比，主要由於以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入增加；環比下降 53.0%，主要由於匯兌損失增加及分佔一家聯營公司溢利減少，部分被利息收入增加所抵消。
- 所得稅收益 190 萬美元，同比上升 501.9%，主要由於轉回上年計提的股利代扣代繳稅金。
- 期內溢利 4,660 萬美元，同比上升 15.9%，環比下降 4.0%。
- 淨利潤率 21.1%，同比上升 2.0 個百分點，環比上升 1.6 個百分點。
- 基本每股盈利 0.037 美元，同比下降 0.002 美元，環比下降 0.005 美元。
- 淨資產收益率（年化）8.8%。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	215,146	97.5 %	206,042	98.1 %	9,104	4.4 %
其他	5,607	2.5 %	4,051	1.9 %	1,556	38.4 %
銷售收入總額	220,753	100.0 %	210,093	100.0 %	10,660	5.1 %

- 本季度 97.5% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	116,569	52.8 %	117,355	55.8 %	(786)	(0.7)%
美國	41,094	18.6 %	40,247	19.2 %	847	2.1 %
亞洲 ⁴	25,018	11.3 %	23,937	11.4 %	1,081	4.5 %
日本 ⁵	19,612	8.9 %	12,121	5.8 %	7,491	61.8 %
歐洲	18,460	8.4 %	16,433	7.8 %	2,027	12.3 %
銷售收入總額	220,753	100.0 %	210,093	100.0 %	10,660	5.1 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.166 億美元，占銷售收入總額的 52.8%，同比減少 0.7%，主要由於模擬產品的需求減少。
- 本季度來自於美國的銷售收入 4,110 萬美元，同比增長 2.1%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,500 萬美元，同比增長 4.5%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 1,960 萬美元，同比增長 61.8%，主要得益於邏輯和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,850 萬美元，同比增長 12.3%，主要得益於智能卡芯片及通用 MOSFET 產品的需求增加。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	84,668	38.4 %	83,716	39.7 %	952	1.1 %
分立器件	83,821	37.9 %	66,199	31.5 %	17,622	26.6 %
模擬與電源管理	23,741	10.8 %	35,409	16.9 %	(11,668)	(33.0)%
邏輯及射頻	24,360	11.0 %	19,227	9.2 %	5,133	26.7 %
獨立非易失性存儲	4,024	1.8 %	5,385	2.6 %	(1,361)	(25.3)%
其他	139	0.1 %	157	0.1 %	(18)	(11.5)%
銷售收入總額	220,753	100.0 %	210,093	100.0 %	10,660	5.1 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,470 萬美元，同比增長 1.1%，主要得益於 MCU 產品的需求增加，部分被智能卡芯片的需求減少所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 8,380 萬美元，同比增長 26.6%，主要得益於超級結、通用 MOSFET 和 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 2,370 萬美元，同比減少 33.0%，主要由於其他電源管理、LED 照明和模擬產品的需求減少。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,440 萬美元，同比增長 26.7%，主要得益於射頻和邏輯產品的需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 400 萬美元，同比減少 25.3%，主要由於閃存產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一九年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第一季度 % (未經審核)	二零一八年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13 μ m 及以下	84,240	38.2 %	70,249	33.4 %	13,991	19.9 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	25,694	11.6 %	28,618	13.6 %	(2,924)	(10.2)%
0.25 μ m	2,472	1.1 %	4,650	2.2 %	(2,178)	(46.8)%
0.35 μ m 及以上	108,347	49.1 %	106,576	50.8 %	1,771	1.7 %
銷售收入總額	220,753	100.0 %	210,093	100.0 %	10,660	5.1 %

- 本季度 0.13 μ m 及以下工藝技術節點的銷售收入 8,420 萬美元，同比增長 19.9%，主要得益於 MCU 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 2,570 萬美元，同比減少 10.2%，主要由於模擬產品的需求減少。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 250 萬美元，同比減少 46.8%，主要由於 MCU 和邏輯產品的需求減少。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.083 億美元，同比增長 1.7%，主要得益於超級結產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一九年	二零一九年	二零一八年	二零一八年	同比	同比
	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	仟美元	%
電子消費品	135,536	61.4 %	142,645	67.9 %	(7,109)	(5.0)%
工業及汽車	44,774	20.3 %	36,709	17.5 %	8,065	22.0 %
通訊	30,131	13.6 %	21,051	10.0 %	9,080	43.1 %
計算機	10,312	4.7 %	9,688	4.6 %	624	6.4 %
銷售收入總額	220,753	100.0 %	210,093	100.0 %	10,660	5.1 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.355 億美元，占銷售收入總額的 61.4%，同比減少 5.0%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 4,480 萬美元，同比增長 22.0%，得益於智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 3,010 萬美元，同比增長 43.1%，主要得益於邏輯、智能卡芯片及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,030 萬美元，同比增長 6.4%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	65	63	65
2 號晶圓廠	60	57	59
3 號晶圓廠	50	48	50
合計	175	168	174
產能利用率	87.3%	97.3%	96.7%

- 本季度末總產能增至 175,000 片。本季度產能利用率 87.3%，主要由於客戶需求減少。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	446	454	531	(1.8)%	(16.0)%

- 本季度付運晶圓 446,000 片，同比減少 1.8%。

經營開支分析

以千美元計	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,025	1,749	2,034	15.8 %	(0.4)%
管理費用 ⁷	29,702	23,698	36,785	25.3 %	(19.3)%
經營開支	31,727	25,447	38,819	24.7 %	(18.3)%

- 經營開支 3,170 萬美元，同比上升 24.7%，主要由於人工費用和技術開發費用上升；環比下降 18.3%，主要由於在上一季度計提了設備減值準備和年終獎金。

其他收入/(損失)淨額

以千美元計	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,184	3,419	2,958	(6.9)%	7.6 %
利息收入	5,638	2,720	3,356	107.3 %	68.0 %
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	5,873	-	6,630	100.0 %	(11.4)%
匯兌損失	(9,691)	(8,823)	(5,394)	9.8 %	79.7 %
分佔一家聯營公司溢利	383	453	3,830	(15.5)%	(90.0)%
財務費用	(316)	(594)	(431)	(46.8)%	(26.7)%
政府補貼	229	420	151	(45.5)%	51.7 %
其他	157	380	520	(58.7)%	(69.8)%
其他收入/(損失)淨額	5,457	(2,025)	11,620	(369.5)%	(53.0)%

- 其他收入淨額 550 萬美元，與上年同期其他損失淨額 200 萬美元相比，主要由於以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入增加；環比下降 53.0%，主要由於匯兌損失增加及分佔一家聯營公司溢利減少，部分被利息收入增加所抵消。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	78,859	57,542	91,939	37.0 %	(14.2) %
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(24,124)	(12,281)	50,342	96.4 %	(147.9)%
融資活動所得現金流量淨額	317,684	189,645	341,703	67.5 %	(7.0)%
外匯匯率變動影響淨額	5,840	7,865	8,736	(25.7)%	(33.2)%
現金及現金等價物變動影響淨額	378,259	242,771	492,720	55.8 %	(23.2)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 7,890 萬美元，同比上升 37.0%，主要由於貿易應收款項及應收票據的回收增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 2,410 萬美元，其中包括設備投資支出 1.102 億美元，部分被(i)收回以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資 7,960 萬美元，及(ii)收到利息收入 650 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 3.177 億美元，其中包括(i) 控股子公司華虹無錫收到資本金 3.170 億美元，(ii)發行股份收到的投資款 80 萬美元，部分被支付利息 10 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)
資產總額	3,521,393	3,078,274
負債總額	400,317	373,942
所有者權益總額	3,121,076	2,704,332
資產負債率 ⁸	11.4%	12.1%

資本開支

以千美元計	二零一九年 第一季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)
華虹宏力	25,322	28,076
華虹無錫	84,895	32,906
合計	110,217	60,982

- 本季度資本開支 1.102 億美元，其中 8,490 萬美元用於華虹無錫。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)
存貨	140,322	129,629
貿易應收款項及應收票據	160,012	176,797
預付款項、按金及其他應收款項	20,360	12,479
應收關聯方款項	6,789	10,800
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	606,094	667,033
已凍結存款及定期存款	796	337
現金及現金等價物	1,155,259	777,000
流動資產總額	2,089,632	1,774,075
貿易應付款項	74,880	79,470
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	151,363	165,370
計息銀行借款	4,455	4,371
租賃負債	1,393	-
政府補助	59,810	44,406
應付關聯方款項	17,697	5,838
應付所得稅	37,699	30,114
流動負債總額	347,297	329,569
淨營運資金	1,742,335	1,444,506
速動比率	5.6x	5.0x
流動比率	6.0x	5.4x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	69	57
存貨周轉天數	81	72

- 存貨由上季度末的 1.296 億美元上升至本季度末的 1.403 億美元，主要由於原材料的上升。
- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1,250 萬美元上升至本季度末的 2,040 萬美元，主要由於對供應商的預付款及待抵扣進項稅的增加。
- 租賃負債根據於二零一九年一月一日起開始生效的香港財務報告準則第 16 號的要求予以確認。根據香港財務報告準則第 16 號，承租人應當對租賃確認使用權資產和租賃負債。使用權資產是指承租人可在租賃期內使用租賃資產的權利，租賃負債是指承租人支付租金的義務。
- 政府補助由上季度末的 4,440 萬美元上升至本季度末的 5,980 萬美元，主要由於收到一項政府資助項目的款項。
- 應付關聯方款項由上季度末的 580 萬美元上升至本季度末的 1,770 萬美元，主要由於收到關聯方的預付租金款。
- 應付所得稅由上季度末的 3,010 萬美元上升至本季度末的 3,770 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 本季度末淨營運資金 17.423 億美元，流動比率 6.0。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數 69 天。
- 本季度末存貨周轉天數 81 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)
銷售收入	220,753	210,093	249,086
銷售成本	(149,756)	(142,708)	(164,508)
毛利	70,997	67,385	84,578
其他收入及收益	15,093	6,647	13,282
投資物業的公平值收益	-	-	247
銷售及分銷費用	(2,025)	(1,749)	(2,034)
管理費用	(29,702)	(23,698)	(36,785)
其他費用	(9,703)	(8,531)	(5,308)
財務費用	(316)	(594)	(431)
分佔一家聯營公司溢利	383	453	3,830
稅前溢利	44,727	39,913	57,379
所得稅收益/(開支)	1,914	318	(8,818)
期內溢利	46,641	40,231	48,561
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	47,466	40,097	48,972
非控股權益	(825)	134	(411)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.037	0.039	0.042
攤薄	0.037	0.038	0.042
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,284,456,115	1,039,145,939	1,162,589,323
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,298,603,115	1,051,206,939	1,172,799,323

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (已審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	853,827	773,180	752,938
使用權資產	17,678	-	-
投資物業	174,523	171,225	186,614
預付土地租賃款項	59,962	58,989	21,267
無形資產	10,087	9,571	7,380
於聯營公司的投資	65,620	64,005	60,285
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	212,370	208,357	224,313
長期預付款項	23,658	3,762	55,005
應收關聯方款項	7,053	8,747	-
遞延稅項資產	6,983	6,363	7,469
非流動資產總額	1,431,761	1,304,199	1,315,271
流動資產			
存貨	140,322	129,629	128,255
貿易應收款項及應收票據	160,012	176,797	125,639
預付款項、按金及其他應收款項	20,360	12,479	11,163
應收關聯方款項	6,789	10,800	52,052
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	606,094	667,033	-
已凍結存款及定期存款	796	337	125,236
現金及現金等價物	1,155,259	777,000	617,661
流動資產總額	2,089,632	1,774,075	1,060,006
流動負債			
貿易應付款項	74,880	79,470	69,037
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	151,363	165,370	110,505
計息銀行借款	4,455	4,371	60,931
租賃負債	1,393	-	-
政府補助	59,810	44,406	44,410
應付關聯方款項	17,697	5,838	22,143
應付所得稅	37,699	30,114	33,660
流動負債總額	347,297	329,569	340,686
流動資產淨額	1,742,335	1,444,506	719,320
總資產減流動負債	3,174,096	2,748,705	2,034,591
非流動負債			
計息銀行借款	26,732	26,227	33,396
租賃負債	16,926	-	-
遞延稅項負債	9,362	18,146	7,872
非流動負債總額	53,020	44,373	41,268
淨資產	3,121,076	2,704,332	1,993,323
權益和負債權益			
股本	1,960,929	1,960,159	1,557,264
儲備	285,854	195,097	246,891
本公司擁有人應佔權益	2,246,783	2,155,256	1,804,155
非控股權益	874,293	549,076	189,168
權益總額	3,121,076	2,704,332	1,993,323

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	44,727	39,913	57,379
折舊及攤銷	30,533	30,178	29,816
應佔聯營公司溢利	(383)	(453)	(3,830)
營運資金的變動及其它	3,982	(12,096)	8,574
經營活動所得現金流量淨額	78,859	57,542	91,939
投資活動所(用)/得現金流量：			
購買物業、廠房及設備項目	(110,217)	(86,691)	(60,982)
其他投資活動所得現金流量	86,093	74,410	111,324
投資活動所(用)/得現金流量	(24,124)	(12,281)	50,342
融資活動所得現金流量：			
非控股權益資本注資	317,000	188,000	-
發行股份所得收益	779	2,186	400,523
償還銀行貸款	-	-	(58,331)
已付利息	(95)	(541)	(489)
融資活動所得現金流量	317,684	189,645	341,703
現金及現金等價物增加淨額	372,419	234,906	483,984
外匯匯率變動影響淨額	5,840	7,865	8,736
期初現金及現金等價物	777,000	374,890	284,280
期末現金及現金等價物	1,155,259	617,661	777,000

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

陳劍波

杜洋

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一九年五月九日